

令和6年12月25日

関係各位

(一社)日本実装技術振興協会  
会長 嶋田 勇三

## 第230回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第230回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回は会場とWEB会議システム(Zoom ウェビナー)を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時: 令和7年1月23日(木)定例講演会 13:00~16:20  
技術交流会 17:00~18:00

2. 開催方式: ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第3研修室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】

(Zoom 参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします)

川崎市産業振興会館: 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム: “シリコンフォトニクスがもたらす高速・省電力通信の新時代”

(1)13:00~14:00 プログラムテーマ①	『3次元光導波路技術の進展と新しい光回路実装への応用』 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 教授 石樽 崇明 氏 講演内容: 本講演では、昨今高い注目を集めている光電融合、Co-Package (CPO) 技術のキーデバイスとして期待されるポリマー光導波路に関して、各研究機関の過去の開発状況から、現状の最先端の開発動向に至るまでを紹介する。特に昨今のトレンドである CPO 応用に向けて①ポリマー光導波路構成材料に対する要求仕様、②3次元光回路化に焦点を当てて、最新ポリマー光導波路作製方法ならびにその特性などを紹介するとともに、社会実装に向けたサプライチェーン動向について解説する。
(2)14:00~15:00 プログラムテーマ②	『シリコンフォトニクス向け透明樹脂材料開発の現状と課題』 ナミックス株式会社 技術開発本部 商材技術 U 次期商材開発 G グループマネージャー 坂井 徳幸 氏 講演内容: インターネットトラフィックは年々増加しており、今後は指数関数的に増大していくと予測されている。そして、インターネットトラフィックの増加は、消費電力増加となり、深刻な電力不足につながることから低消費電力化が急務となっている。低消費電力化の方法として半導体の微細化に取り組んでいるが、半導体の微細化は限界に近づいている。そこで、半導体の微細化以外の低消費電力化の方法として、光電融合したシリコンフォトニクス技術が検討されている。本講演では、シリコンフォトニクスで重要な役割を担う光ファイバー/光電変換素子接続用の透明接着剤について、説明する。
15:00~15:20	— 休憩 —
(3)15:20~16:20 プログラムテーマ③	『光インターコネクの実装形態とシリコンフォトニクストランシーバの開発動向』 古河電気工業株式会社 フォトニクス研究所・フェロー/光電融合技術開発部長 那須 秀行 氏 講演内容: データセンターインターコネクの広帯域化および長距離化を実現するために光インターコネクは採用された。さらなる広帯域化と省電力化を実現するために、光インターコネクの実装形態が変化してきており、現在、AI/Machine Learning の普及にけん引され、光電融合技術の第1段階とされる Co-Packaged Optics (CPO) の導入が期待されている。本講演では、光インターコネクの実装形態が変わる背景と導入される技術について解説する。また、CPO において適用が期待されているシリコンフォトニクストランシーバの開発動向についても解説する。
17:00~18:00	— 技術交流会 — 産業振興会館2階「カフェサウダージ」にて

#### 4. 参加費

**会 員:**無料 企業正会員は1社3名まで(Web 会議特例:3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください)。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。

**会員外:**22000 円/人(不課税)(お申し込み後、請求書をお送りします)

#### 5. 参加申し込み

**会 員:**会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙(企業正会員には登録代表者(連絡担当者)にお送りしています)にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場とZoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

**会員外:**ホームページのお問い合わせフォーム(<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>)より「お問い合わせ内容」の項目に第 230 回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。参加方式(会場もしくは Zoom)もご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。

申込締切日:会 員 令和7年 1月 14日(火)

会員外 令和7年 1月 9日(木)

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようにお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日 1 週間前に郵便で発送させていただきます(企業正会員は登録代表者(連絡担当者)にお送りします)。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局:一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田

携帯:090-5403-1147(相良)、090-5301-9467(太田)

E-mail: [j.jisso.org@gmail.com](mailto:j.jisso.org@gmail.com) URL:<http://www.j-jisso.org/index.html>